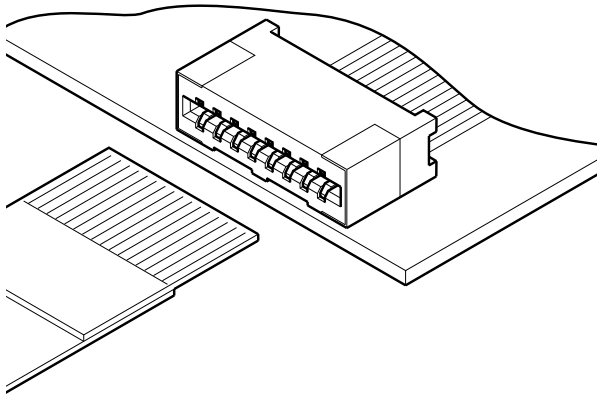


FMS CONNECTOR

1.0mmピッチプリント基板用／FFC用・Non-ZIFタイプ



1.0mmピッチFFC 接続に対応したSMTタイプのコネクタです。実装高さ2.8mmのコンパクト設計。両面接続リーフコンタクト採用により、リード部導体面の配慮を必要とせず、実装設計が容易です。自動実装に対応したエンボステーピング供給が可能です。

■特長

- ・実装高さ2.8mmのコンパクト設計
ピッチ1.0mm、実装高さ2.8mm、幅6.3mmの小型設計です。
- ・両面接触による高信頼設計
コンタクトは、ばね性に優れた青銅を使用した高接触圧の両面接触構造で、FFCとの確実な接続が得られます。また両面接触構造のため、リード部の導体面に対する配慮を必要とせずコネクタにFFCを接続できますので、実装設計が容易です。
- ・接続が簡単なスナップイン方式
FFCリードをコネクタに挿入するだけの簡単な作業で、ケーブルの接続と保持ができるスナップイン方式。
- ・表面実装 (SMT) タイプ
電子機器内部素子のSMT化に対応し、ハウジングに耐熱性に優れた樹脂を採用した、リフローはんだ対応の表面実装タイプです。実装設計のより高密度化が可能になります。
- ・嵌合時の浮き上り防止
コネクタの両サイドに補強金具を設け、FFC接続時のこじり挿抜等によるコネクタの浮き上りを防止しました。

■登録規格

Ⓜ : Recognized E60389
Ⓔ : Certified LR 20812

■一般仕様

- ・定格電流：0.5A AC/DC
- ・定格電圧：50V AC/DC
- ・使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- ・接触抵抗：初期／20mΩ以下
耐候性試験後／30mΩ以下
- ・絶縁抵抗：800MΩ以上
- ・耐電圧：AC 500Vを1分間印加にて絶縁破壊なきこと
- ・適用 FFC：導体ピッチ／1.0mm
導体幅／0.7mm
接触部厚さ／0.30 ± 0.05mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

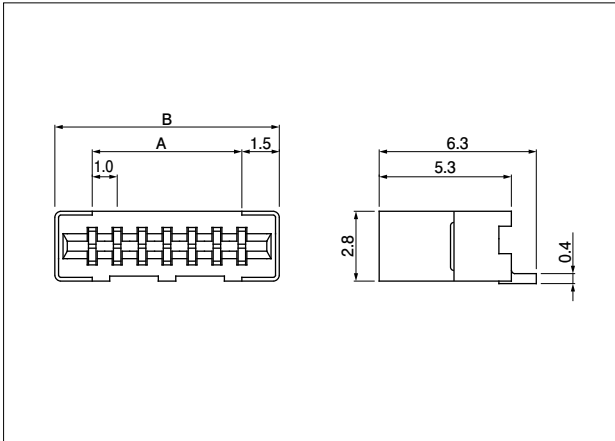
※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

FMS CONNECTOR

コネクタ



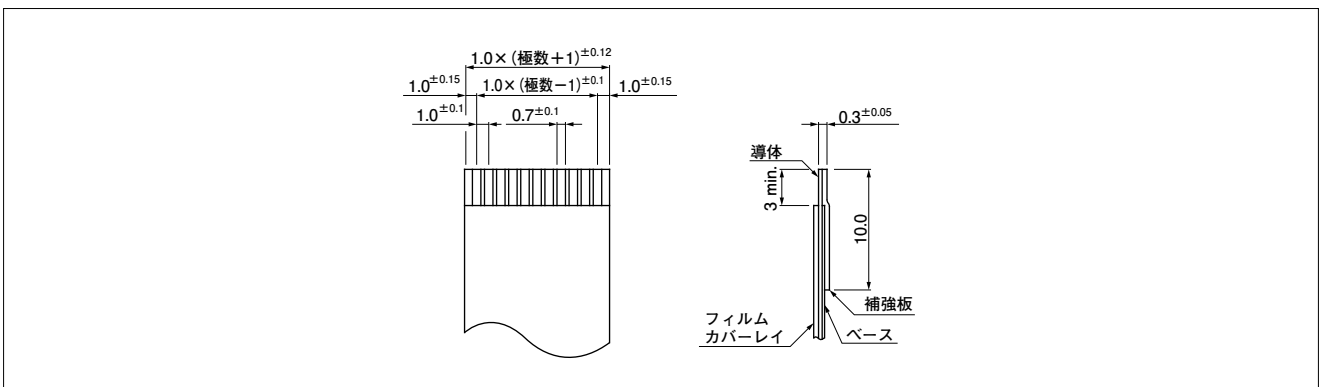
| 極数 | 形番 | 寸法 (mm) | | 個数／リール |
|----|----------------|---------|------|--------|
| | | A | B | |
| 3 | 03FMS-1.0SP-TF | 2.0 | 5.0 | 2,500 |
| 4 | 04FMS-1.0SP-TF | 3.0 | 6.0 | 2,500 |
| 5 | 05FMS-1.0SP-TF | 4.0 | 7.0 | 2,500 |
| 6 | 06FMS-1.0SP-TF | 5.0 | 8.0 | 2,500 |
| 8 | 08FMS-1.0SP-TF | 7.0 | 10.0 | 2,500 |
| 10 | 10FMS-1.0SP-TF | 9.0 | 12.0 | 2,000 |
| 12 | 12FMS-1.0SP-TF | 11.0 | 14.0 | 2,000 |
| 14 | 14FMS-1.0SP-TF | 13.0 | 16.0 | 2,000 |

材 料・表面処理等

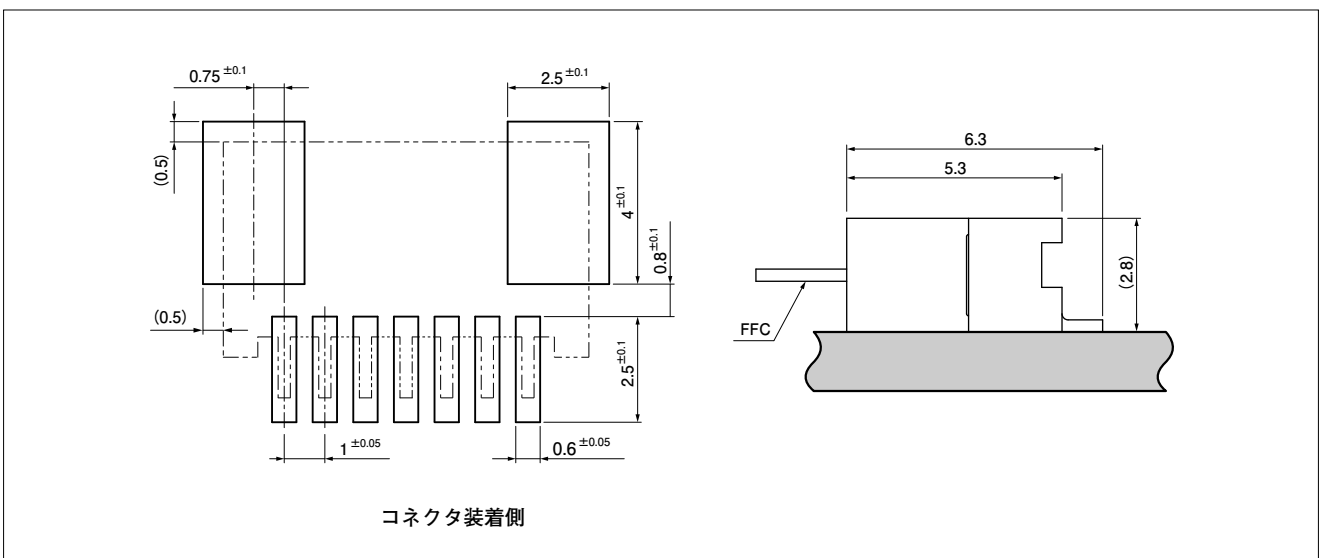
コンタクト：りん青銅、銅下地付すずめっき
 ハウジング：PPS、UL94V-0
 補強金具：黄銅、銅下地付すずめっき

本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
 本製品はエンボステーピング供給品です。

FFC リード部寸法



基板レイアウト・組立レイアウト



注) 基板のパターンピッチは公差±0.05で累積しないこと。 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。